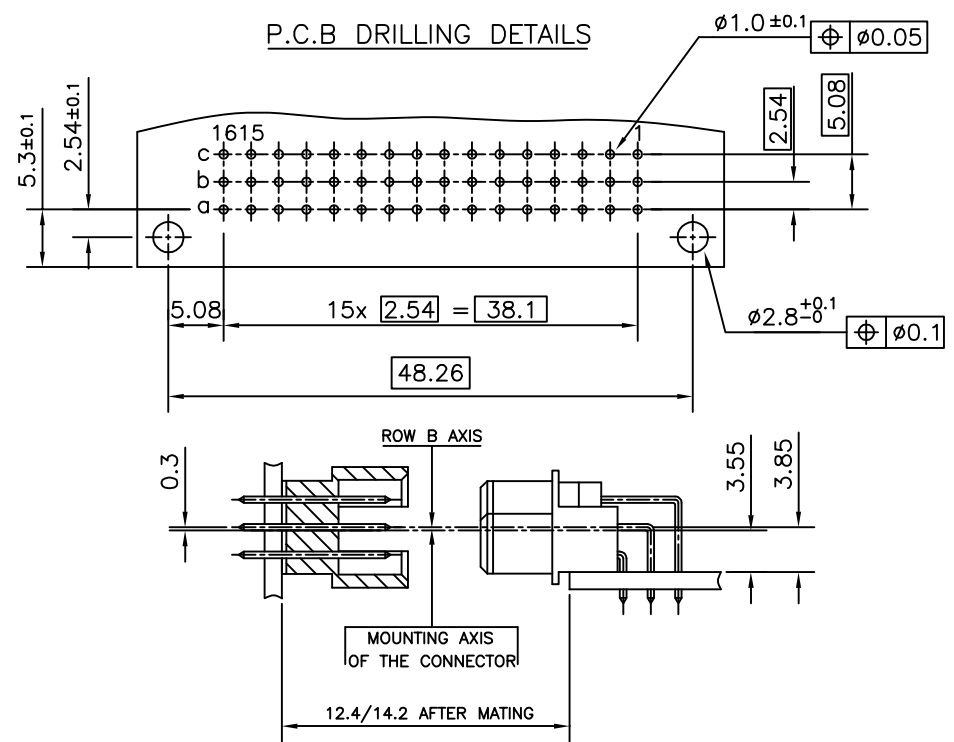
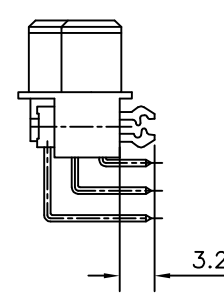
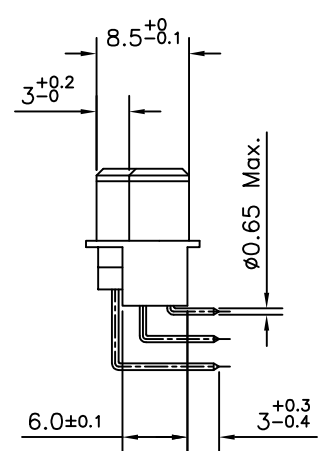
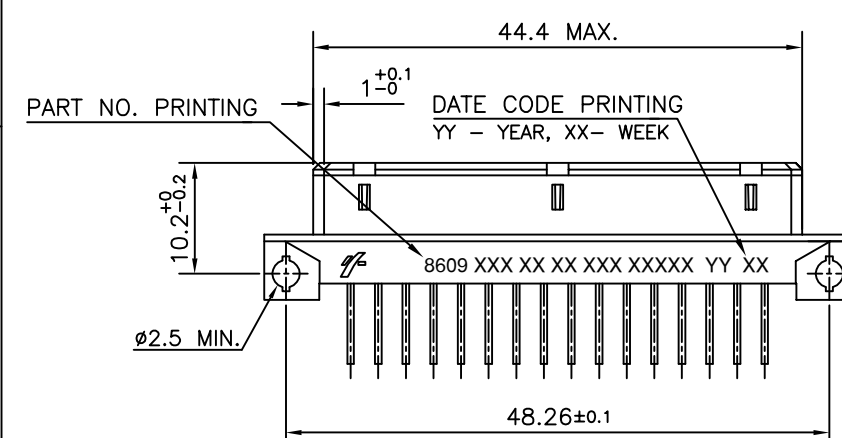
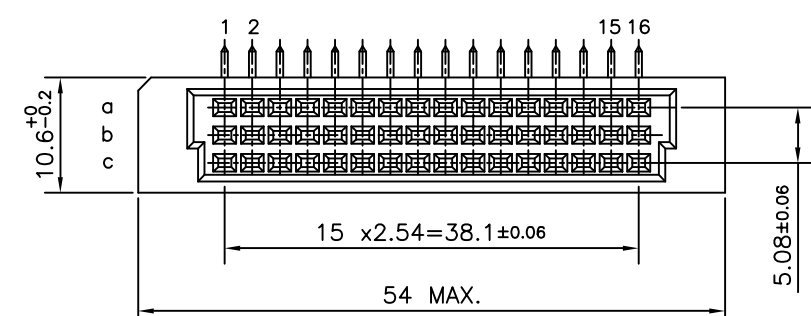




TECHNICAL SPECIFICATION

HOUSING MATERIAL : THERMOPLASTIC POLYESTER UL 94V-0, GREY

HOUSING CAN WITHSTAND EXPOSURE TO LEAD FREE WAVE SOLDERING TEMPERATURE OF 260-265°C WHEN USED WITH PROTECTIVE ADHESIVE OR PROTECTIVE METTALIC DEVICE FOR RIGHT ANGLE CONNECTORS AS IT IS USED IN CLASSICAL LEAD WAVE SOLDERING AT 235-250°C

CONTACT MATERIAL : COPPER ALLOY

CONTACT PLATING : GOLD OVER NICKEL

ACTIVE ZONE : GOLD OVER NICKEL

TERMINATION ZONE : GOLD OVER NICKEL

TIN LEAD VERSION : TIN LEAD OVER NICKEL

LEAD FREE VERSION : TIN (PURE MATTE) OVER Ni

HARPOON PLATING : GOLD OVER NICKEL

TIN LEAD VERSION : TIN LEAD OVER NICKEL

LEAD FREE VERSION : TIN (PURE MATTE) OVER Ni

ELECTRICAL DATA

CURRENT RATING AT 20°C : 1,5 A

CURRENT (I MAX) : 2 A

TEMPERATURE RANGE : -55°C/ +125°C

CONTACT RESISTANCE : ≤ 20mΩ

INSULATION RESISTANCE : ≥ 10⁶ MΩ

TEST VOLTAGE (rms) : 1000V

MECHANICAL DATA

INSERTION FORCE PER CONTACT : ≤ 0.94N

EXTRACTION FORCE PER CONTACT : ≥ 0.15N

REFERENCE SPECIFICATIONS : DIN 41612 / IEC 603-2

SERIES	8609	3	48	8	6	13	7	6	5	000E1
ROWS FITTED WITH CONTACTS										
Rows a b c		3	48							
Rows a - c		4	32							
NUMBER OF CONTACTS										
TYPE OF INSULATOR										
3 ROW FEMALE INSULATOR				8						
METHOD OF MOUNTING										
REVERSE MOUNTING - STYLE R/2					6					
TERMINATION										
ANGLED SPILL						13				
OPTIONS										
NO OPTION							7			
WITH HARPOONS							H			
PERFORMANCE CLASS										
DIN 41612 CLASS 3							4			
DIN 41612 CLASS 2							5			
DIN 41612 CLASS 1							6			
AS PER MIL C 55302/ JSS 50808							8			
PITCH PER ROW										
2.54							5			
000E1										TIN LEAD VERSION
E1LF										LEAD FREE VERSION

NOTES:-

1. THE "LF" PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

2. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 3.5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6 MM MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD

3. LEAD FREE OR RoHS DIRECTIVE LABELING TO BE PROVIDED AS PER GS-14-920 FOR LEAD FREE VERSION.

mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family
-	ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		8609
ltr	ecn no	dr	date	title
A	I04-0100	MINI	09/11/2004	DIN REVERSE RECEPTACLE
B	I05-0042	MINI	19/05/2005	ANGLED SPILL DIN 41612 STYLE-R/2
C	I06-0063	MINI	01/06/2006	
	dr	MINI K VANDANATH	23/09/2004	dwg no
	enr	RAKHEE GEORGE	23/09/2004	sheet 1 of 1
	chr	RAKHEE GEORGE	01/06/2006	size
	appd	RAKHEE GEORGE	01/06/2006	A3
sheet index	revision	C		type
	sheet	1		Product Customer Drawing

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9